

## 关于我们

奇异摩尔是全球首批专注于2.5D及3DIC Chiplet产品及服务的公司, 基于下一代计算体系架构, 提供全球领先的Chiplet高性能通用芯粒及解决方案, 助力高算力芯片实现性能飞跃, 产品主要应用于下一代数据中心、自动驾驶、个人计算平台等高速增长市场。

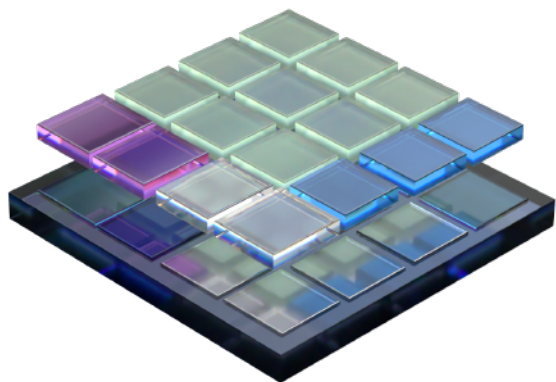
## Chiplet 全链路团队

**核心团队:**均来自全球半导体行业巨头, 如NXP、Alchip、AMD、Intel、Broadcom、NCAP等;

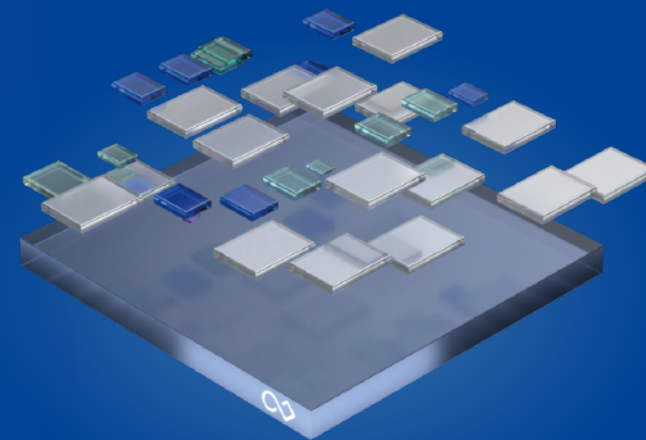
**领域覆盖:**市场管理、产品架构、软件硬件、先进封装等

**团队构成:**研发占比80%+, 博士占比20%+;

**项目经验:**10+高性能Chiplet量产项目经验。



面向下一代高性能计算场景



上海 / 西安 / 无锡

# 奇异摩尔

## 远见, 超越芯所未见



上海办公室: 上海市浦东新区五星路727弄6号楼2层

西安办公室: 陕西省西安市雁塔区唐延路51号人寿壹中心

无锡办公室: 无锡新吴区震泽路18-17号软件园二期双子座B座

公司官网: <https://www.kiwimoore.com>

## 通用产品和方案, 解决专用领域的挑战



基于Chiplet架构、通用互连芯粒、设计工具, 及海量第三方芯粒库, 奇异摩尔致力于打造全球领先的Chiplet通用产品解决方案。客户只需自研部分核心芯粒, 复用其他通用单元进行设计组合, 即可快速构建所需专属高性能芯片, 极大降低研发成本和设计周期。同时, 经由Chiplet超高速互连形成超大规模系统级芯片 (M-SOC), 助力提升芯片性能和能效, 共同突破摩尔定律边界。

## Chiplet 设计及量产服务

### 1 Chiplet 组合方案及设计服务

面向下一代数据中心、自动驾驶、个人计算平台打造一站式Chiplet组合方案, 涵盖系统架构、通用底座、芯粒选型、封装形式等全链路服务, 客户既可直接采用标准方案量产, 也可自行或委托奇异摩尔进行设计。



### 1 高性能通用底座 Base Die

超高性能3DIC多功能通用底座

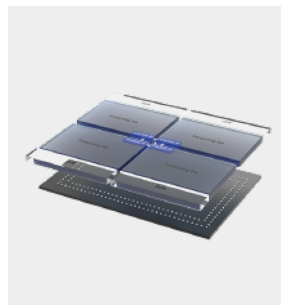
- 3D超高速Die2Die
- PCIe、DDR、HBM等高速接口
- Chiplet片上网络Kiwi Fabric
- 自适应互连控制中心
- 大容量3D近存
- 大电流供电网络
- 适用于3D Chiplet架构
- 支持3DIC先进封装



### 3 Die2Die 接口IP

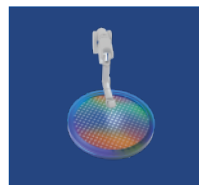
低延时Chiplet专用Die2Die接口IP

- 全面支持UCIe标准
- 卓越综合性能, 高带宽、低功耗、低延时三者兼顾
- 全面支持2.xD/2.5D/3D, 涵盖Substrate, RDL/Silicon Interposer, 3DIC等多种封装技术
- 含Controller, PHY, verification IP



### 2 芯粒打样封测

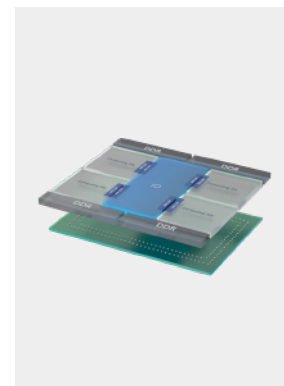
在Chiplet生产和测试方面有着丰富的实践经验, 同时拥有多样化的产业资源, 可提供世界领先水平的先进封装设计、小规模打样测试和其他服务, 以尽可能低的成本助力客户解决Chiplet领域中最棘手的挑战。



### 2 高速互连芯粒 IO Die

高性能Chiplet互连接口芯粒

- 2.xD/2.5D超高速Die2Die
- PCIe、DDR等高速接口
- Chiplet片上网络Kiwi Fabric
- 自适应互连控制中心
- 适用于2.xD/2.5DChiplet架构
- 支持Substrate, RDL/Silicon Interposer 等先进封装技术



### 4 Chiplet软件设计平台

Chiplet专用设计工具, 支持Base Die, IO Die自动完成产品设计

- 支持Auto-Routing, 3D-Stacking, Die Configuration等功能
- 无缝结合主流EDA工具, 快速完成Chiplet系统设计、验证、仿真等复杂工作



### 3 Chiplet 量产服务

与主流FAB及OSAT通力协作, 提供Chiplet量产管理服务; 客户只需自研核心芯片, 无需管理其他芯粒及复杂封测流程, 即可轻松实现Chiplet量产; 并可以通过共享奇异摩尔平台供应链体系, 有效降低量产成本。

